Willkommen bei O-Leading

Wir sind professionelle Leiterplattenhersteller mit mehr als zehn Jahren Erfahrung. Produktpalette: einseitige, doppelseitige, mehrschichtige Leiterplatte, flexible Leiterplatte und MCPCB. Wir können einen Rapid Prototyping-Service anbieten: S / S in 24 Stunden, 4-8 Einheiten in 48-96 Produktionsstunden. ((Hersteller von schwerem Kupferporzellan)

KUPFERPLATTENLÖCHER MINDESTENS .025 AVG, .020 MIN .. LÖCHER KÖNNEN NICHT VERBUNDEN WERDEN

Verpackung mit farbloser transparenter Luftpolsterfolie, 25 Stück / Beutel, Trockenmittel auf die Seite legen, Feuchtigkeitsanzeigetafel auf die Oberseite legen

KLICKEN SIE HIER FÜR WEITERE INFORMATIONEN:

Produktbeschreibung

PCB P / N.	LE-150
Schichten zählen	1L
Material	Grundkeramik
Der Aufsichtsrat	3,2 mm
thk von Kupfer	1 Unze
Kleinste Lochgröße	/.
Anzahl der Löcher (Stücke)	/.
Linie w / s	/.
S / N-Impedanzprüfung (Tol%)	N.
Oberflächenfinish	ENIG (Au: 0,05 um)
Siebdruckschweißmaske	Schwarz-Weiss
Einzelne Dimensionen	Dim X (mm): 27; Dim Y (mm): 45
Panelisierung	Dim X (mm): 27; Dim Y (mm): 135; UPS Nr. 3
Besonderheit: abziehbare Maske	N.
Routing / Stanzen	Senkkopf CNC Schraube +

•

Leiterplattenhersteller mit China-Kupferbasis

Unser Team

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable

Zertifizierungen

Quality Management System Certificate

This is to certify that
(Organization Code Certificate : 61691591-000-07-16-8)

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO.,LIMITED

ROOM 603D, 6/F HANG PONT COMMERCIAL BUILDING, 31 TONKIN ST.,
CHEUNG SHA WAN, KL, HK

has been established the quality management system meeting the requirements of standard

GB/T19001-2008/ISO9001:2008

Scope:

Certification Address: Room 1313, Fortune Building, Nanheng West Road, Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China

Certification Activities: Sales and services of printed circuit boards

Certificate No.: 51816Q01163R0S

Issued Date : 2016-11-17 Valid to : 2018-09-15

Initial Issued Date : 2016-11-17 Renewal Date : ***

CCAC

GM

CICC INSPECTION CERTIFICATION

CICC CERTIFICATION
嘉泰认证

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No: 1811BQ10347R0S

We hereby certify that

O-LEADING SUPPLY CHAIN(HK) CO.,LIMITED

Credit No: 61691591-000-07-17-2

Registration Add:ROOM 603D,6/F HANG PONT COMMERCIAL BUILDING,31 TONKIN ST,CHEUNG SHA WAN,KL,HK

Business Add:1313,Floor 13,Fortune Building,Danshui Town,Huiyang District, Huizhou,Guangdong,China

Has implemented and maintains a **Quality Management System**
Which fulfils the requirements of the following standards
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

Scope of certification

Sales of printed circuit boards

Initial Issuance period: February 27, 2018

This certificate is valid during: February 27, 2018 — February 26, 2021

This certificate is invalid without CICC qualified label in the following period

First supervision and audit	Qualified mark	Second supervision and audit	Qualified mark

CICC IAF CNAS

ONLINE CERTIFICATIONS DIRECTORY

ZPMV2.E490354
Wiring, Printed - Component

For enhanced search functionality, please visit UL's iQ™ Family of Databases.
Click on a product designation for complete information.

Page Bottom

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

O-LEADING SUPPLY CHAIN CO LIMITED E490354
Fortune Building, Nanheng West Road
Room 1313
Huizhou, Guangdong 516211 CHINA

Type	Cond Width Min mm(in)	Min Edge mm(in)	Cond Thk mic(mil)	SS/ DS/ DSO	Max Area Diam mm(in)	Solder Limits C	Solder Limits sec	Max Oper Temp C	Flame Class	Meets UL796 DSR	CTI
Multilayer (mass laminate) printed wiring boards.											
O-LEADING-401											
	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-	-
O-LEADING-407											
	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	DS	9.7 (0.4)	260	10	130	V-0	All	-
Multilayer printed wiring boards.											
O-LEADING-408											
	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) Int:135	DS	50.8 (2.0)	280	20	130	V-0	All	*
Single layer printed wiring boards.											
O-LEADING-002											
	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	All	-
O-LEADING-003											
	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	▲	-
O-LEADING-033											
	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	All	-
O-LEADING-205											
	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	69.8 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-
O-LEADING-206											
	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.
Last Updated on 2017-01-27

Questions? Print this page Terms of Use Page Top

SGS

Test Report No. CANEC1805164701 Date: 03 Apr 2018 Page 2 of 6

Test Results :

Test Part Description :

Specimen No.	SGS Sample ID	Description
SN1	CAN18-051647.001	Green "PCB"

Remarks :

(1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
(2) MDL = Method Detection Limit
(3) ND = Not Detected (< MDL)
(4) "-" = Not Regulated

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Test Method : With reference to IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC62321-5:2013, IEC62321-7-2:2017 , IEC 62321-6:2015 and IEC62321-8:2017, analyzed by ICP-OES , UV-Vis and GC-MS .

Test Item(s)	Limit	Unit	MDL	001
Cadmium (Cd)	100	mg/kg	2	ND
Lead (Pb)	1,000	mg/kg	2	9
Mercury (Hg)	1,000	mg/kg	2	ND
Hexavalent Chromium (CrVI)	1,000	mg/kg	8	ND
Sum of PBBs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Dibromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tribromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Pentabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Hexabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Heptabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Octabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Nonabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Decabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Sum of PBDEs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Dibromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tribromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Pentabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND

Member of the SGS Group (SGS SA)

Verpackung & Lieferung

Details auf der Verpackung	Professioneller Hersteller von Leiterplatten seit 16 Jahren
Lieferdetail	7-12 Tage

FAQ

PCB mit Kupferfüllung Großhandel

1. Wie garantiert O-Leading Qualität?
Unser hoher Qualitätsstandard wird mit folgenden erreicht.
1. Der Prozess wird streng nach den Normen ISO 9001: 2008 kontrolliert.
2. Umfangreicher Einsatz von Software bei der Verwaltung des Produktionsprozesses
3. Modernste Testwerkzeuge und Werkzeuge. Zum Beispiel. Flugsonde, Röntgeninspektion, AOI (Automated Optical Inspector) und ICT (In-Circuit-Test).
4. Spezifiziertes Qualitätssicherungsteam mit Fehlerfallanalyseprozess
5. Schulung und kontinuierliche Schulung des Personals

2. Wie hält O-Leading den wettbewerbsfähigen Preis?
In den letzten zehn Jahren hatten sich die Preise für viele Rohstoffe (z. B. Kupfer, Chemikalien) verdoppelt, verdreifacht oder vervierfacht. Die chinesische RMB-Währung hatte gegenüber dem US-Dollar um 31% aufgewertet. Auch unsere Arbeitskosten sind deutlich gestiegen. O-Leading hat unsere Preise jedoch konstant gehalten. Hier geht es um unsere Innovationen bei der Kostensenkung, Abfallvermeidung und Effizienzsteigerung. Unsere Preise sind in der Branche bei

gleichem Qualitätsniveau sehr wettbewerbsfähig.
Wir glauben an eine Win-Win-Partnerschaft mit unseren Kunden. Unsere Partnerschaft ist für beide Seiten von Vorteil, wenn wir Ihnen einen Kosten- und Qualitätsvorteil bieten können.

3. Welche Arten von Karten kann der O-Leading-Prozess ausführen?
FR4-Platten mit hohem TG und hohem Halogengehalt, Rogers, Arlon, Telfon, Aluminium / Kupfer-Platten, PI usw.

4. Welche Daten werden für die Leiterplattenherstellung benötigt?
Es ist besser, Daten im Gerber 274-X-Format bereitzustellen. Darüber hinaus können auch Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP und Eagle verarbeitet werden.

5. Was ist der typische Prozessablauf für mehrschichtige Leiterplatten?
Schneidematerial → Interner Trockenfilm → Internes Ätzen → Interner AOI → Mehrfachbindung → Schichtüberlappung Pressen → Bohren → PTH → Plattieren → Externer Trockenfilm → Plattieren → Externe Gravur → Externer AOI → Schweißmaske → Komponentenmarkierung → Endbearbeitungsfläche → Fräsen → E / T → Sichtprüfung.